

DET

**Department of Electronics and Telecommunications** 

Cenni di Fisica dei Dispositivi Elettronici a Semiconduttore (transistori MOS)

### Concetti base

- Fabbricazione dei circuiti integrati
  - Fotolitografia
  - Leggi di Moore



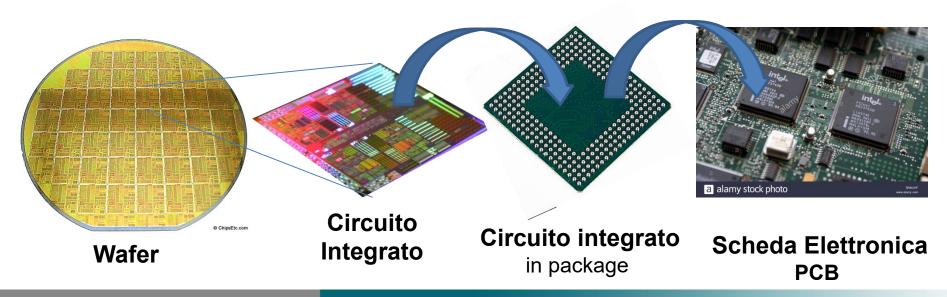
# Dispositivi Elettronici

 Il funzionamento dei sistemi elettronici si basa sulle caratteristiche dei dispositivi elettronici a semiconduttore, fabbricabili in larghissima scala mediante la tecnologia dei circuiti integrati (Integrated Circuits, IC)

Dimensioni dispositivi: ordine di 12nm

Dispositivi in un IC: >109

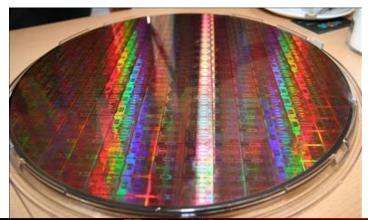
Frequenza di clock: >10 GHz (dig. clk)

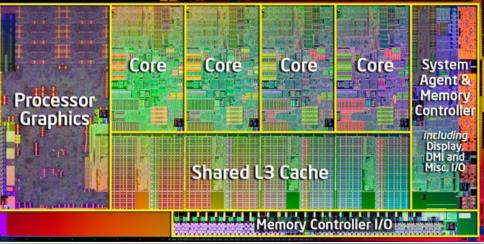


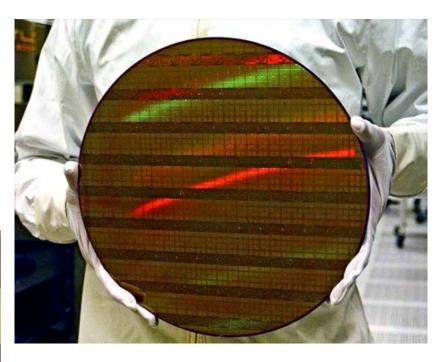


# Circuiti integrati

I circuiti integrati sono principalmente realizzati su wafer di silicio







**INTEL Core i7** 



#### Moore's Law 10G 15 Core 16 Core SPARC T3 SPARC 64X 6 Core i7 8 core POWER 7 The number of integrated 1G - 8 core Xeon Ne. components per IC doubles Core i7 Core 2 Duo every 1.5/2 years 100M AMD K8 Pentium 4 Atom AMD K7 Si ottiene mediante lo 10M POWER 1 • scalamento delle **Transistors** Pentium I AMD K5 dimensioni dei singoli PowerPC 601 80486 • • 1M dispositivi: 70% ogni 2/3 80386. anni (Mac II) 68020. (PC AT) 80286 100k ARM2 (Mac) 68000° 1000 8088 (IBM PC) 10k -• Z80 (TRS80) 100 •6502 (C64) 4004 1k TTL . CMOS 100 10



100

node (nm)

1

1980

20

1990

Year

10

1965

1970

40

2010

50

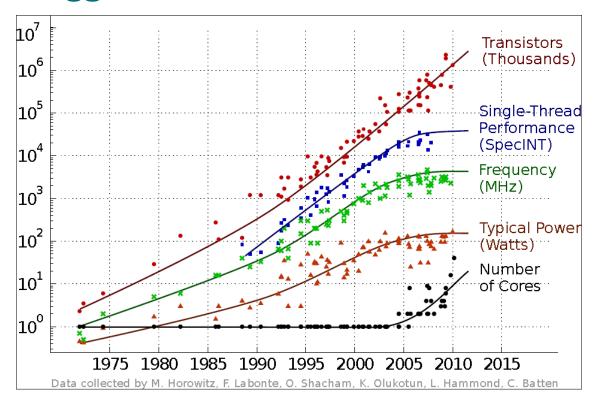
2015

30

2000

# Limiti fisici: la fine della legge di Moore?

Lo scalamento da solo non basta: le dimensioni raggiunte (10 nm) rendono necessario considerare la creazione di nuovi dispositivi, anche sfruttando effetti di natura quantistica (tunnelling, spin, entanglement)





# Litografia

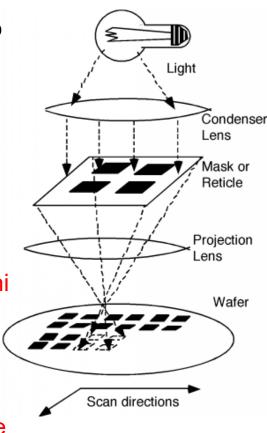
Il circuito integrato è una successione di "regioni" del wafer di silicio (dispositivi) interconnesse tra loro con piste metalliche e/o isolate tra loro con ossidi.

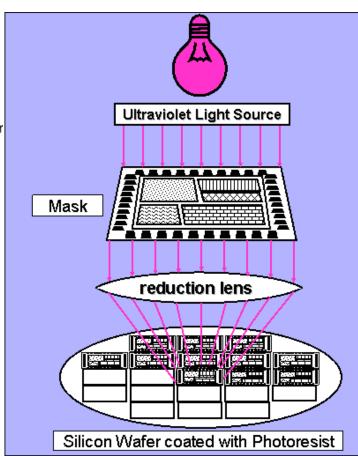
Le dimensioni nanometriche si ottengono utilizzando luce collimata

La successione di chiari e scuri permette di deporre/scavare il materiale in maniera selettiva

Il processo viene ripetuto per ottenere nelle posizioni volute:

- piste metalliche
- strati di ossido
- zone di silicio con proprietà fisiche diverse







### Concetti base

#### Semiconduttore

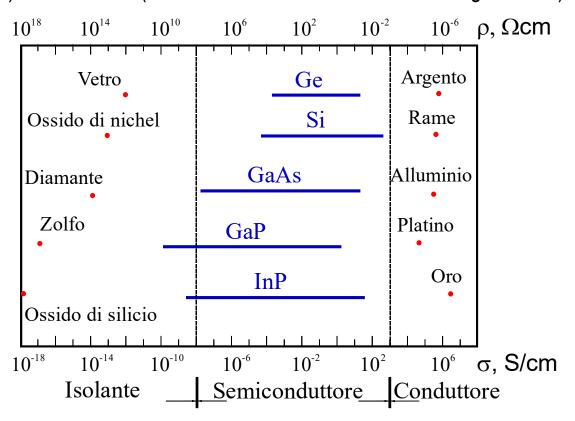
- Meccanismi di conduzione
  - Elettroni e lacune
  - Banda di conduzione e di valenza
- Semiconduttori drogati
  - Drogaggio di tipo n e p

#### Transistore MOS

- Struttura Metallo-Ossido-Semiconduttore
  - Regione di inversione e canale
- Transistore MOS
  - Contatti di *drain* e di *source*
  - Formazione del canale e tensione di soglia
  - Controllo della conduzione tra drain e source attraverso il gate attraverso la tensione tra gate e source

### **Semiconduttori**

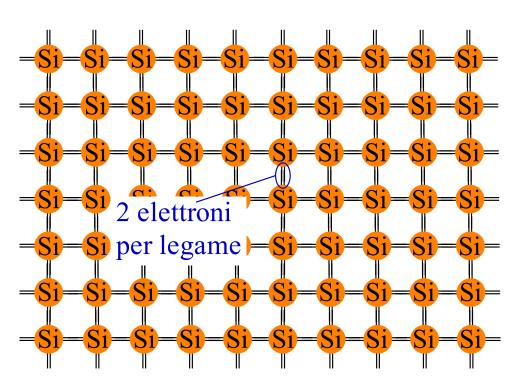
**Semiconduttori:** materiali (tipicamente solidi cristallini) con caratteristiche di conduzione (resistività  $\rho$ , conducibilità  $\sigma=1/\rho$ ) intermedie tra **isolanti** o **dielettrici** (= che non conducono corrente elettrica) **e conduttori** (= che conducono corrente in modo significativo)





### Semiconduttori

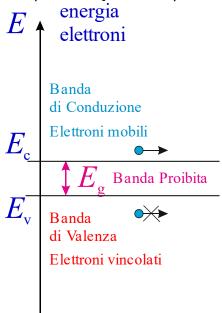
# Silicio (IV gruppo): quattro elettroni esterni



Nel reticolo cristallino del Si, gli elettroni esterni a energia minore sono impegnati a formare legami (banda di valenza, BV)

Gli elettroni con energia maggiore sono liberi di muoversi (banda di conduzione, BC)

I limiti inferiori/superiori di BC e BV sono distinti e non sono consentiti livelli intermedi (banda proibita)

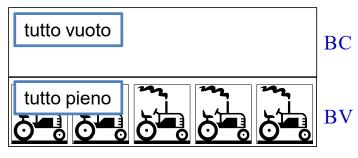


### Semiconduttori

Nei semiconduttori la conduzione è legata a due meccanismi distinti:

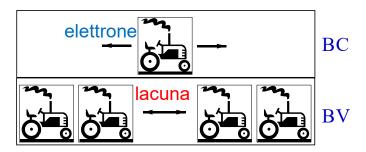
- spostamento di elettroni liberi in banda di conduzione (cariche negative)
- spostamento di lacune (=mancanza di elettroni nei legami covalenti) in banda di valenza (equivalgono a cariche positive mobili)

#### Modello dell'autorimessa



#### No conduzione

#### Modello dell'autorimessa

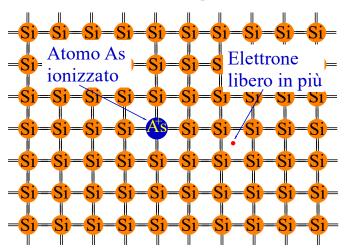


Sia gli elettroni sia le lacune, spostandosi danno luogo ad una corrente

# Semiconduttori: Drogaggio

L'importanza dei semiconduttori risiede nella possibilità di cambiarne la conducibilità elettrica di diversi ordini di grandezza grazie all'introduzione di opportuni atomi droganti

### Silicio drogato n



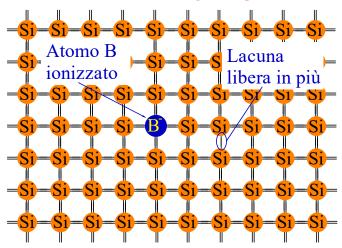
atomi donatori (esempio: As o P per Si), 1 elettrone in più di Si nel guscio più esterno → semiconduttore *drogato n* 

per ogni atomo di drogante ionizzato:

1 carica negativa (elettrone) mobile

1 carica positiva fissa

#### Silicio drogato p



atomi accettatori (esempio: B per Si)

1 elettrone in meno di Si nel guscio più esterno

→ semiconduttore *drogato p* 

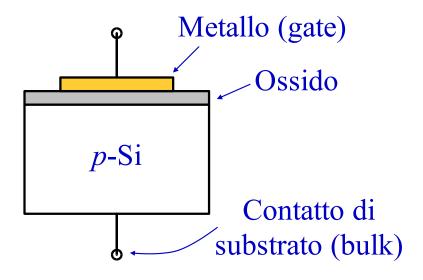
per ogni atomo di drogante ionizzato:

1 carica positiva (lacuna) mobile

1 carica negativa fissa



### Struttura Metallo-Ossido-Semiconduttore



Condensatore a facce piane parallele Metallo-Ossido-Semiconduttore (MOS):

- un'armatura è in metallo (oppure di Si policristallino)
- il dielettrico è ossido di silicio SiO<sub>2</sub>
- la seconda armatura è di semiconduttore (assumiamo Si drogato p)

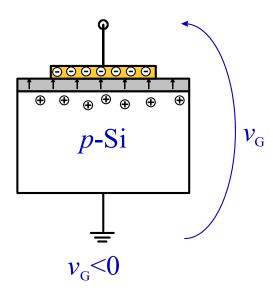
Idea base: cambiare le caratteristiche di conduzione **nel semiconduttore** applicando una *tensione di controllo* alle armature del condensatore MOS



### Struttura Metallo-Ossido-Semiconduttore

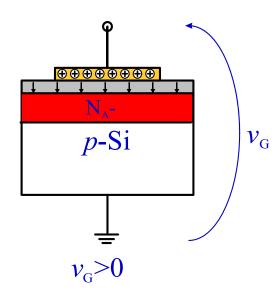
Che cosa succede applicando una tensione  $\mathbf{v_G}$ ?

#### Accumulo di lacune



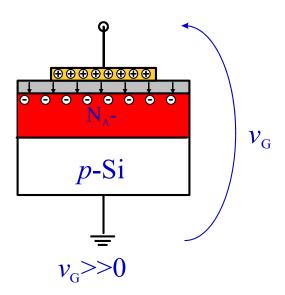
La carica **positiva** sull'armatura di Si è **mobile**, è costituita da lacune (=portatori maggioritari nel *p*-Si)

#### Svuotamento di lacune



La carica *negativa* sull'armatura di Si è *fissa*, è costituita dai droganti accettatori ionizzati (carica fissa)

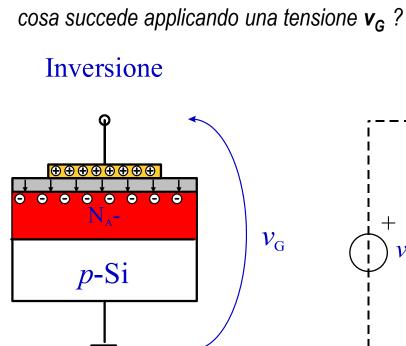
#### Inversione



Aumentando ancora  $v_G$  la carica degli accettatori non basta... si genera sull'armatura di Si anche un sottile strato (*canale*) di carica *negativa mobile: elettroni* 

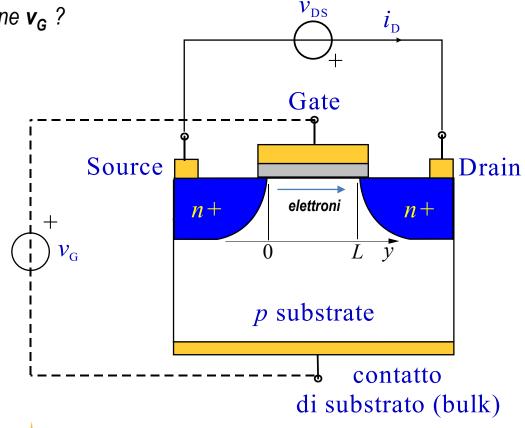


# Transistore MOS a quattro terminali



Aumentando ancora  $v_G$  oltre la **Tensione di Soglia**  $V_{TH}$  si aggiunge sull'armatura di Si anche uno strato (*canale*) di carica *negativa mobile: elettroni* 

 $v_{\rm G} >> 0$ 

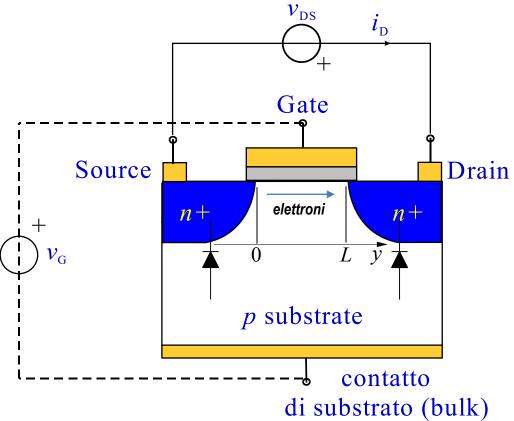




IDEA: sfruttare la carica mobile (=elettroni) del canale in inversione (che è controllata da  $v_G$ ) per **controllare** la conduzione del semiconduttore in direzione parallela al *gate* 



## Transistore MOS a quattro terminali



Si introducono regioni drogate *n*+ (=molto drogate *n*, quindi molto conduttive) per contattare il canale sui due lati (*source e drain*)

Queste regioni drogate *n*+ formano con il substrato delle giunzioni *pn*+ (diodi)

Se il potenziale del *drain* e del *source* è maggiore di quello del substrato, le giunzioni pn+ sono polarizzate inversamente  $\rightarrow$  le lacune non possono passare dal substrato p ai terminali di drain/source

Gli elettroni del canale in inversione possono passare ai terminali di drain/source dando luogo a passaggio di corrente nel circuito esterno per  $v_{DS} \neq 0$ V



IDEA: sfruttare la carica del canale in inversione (che è controllata da  $v_G$ ) per **controllare** la conduzione del semiconduttore nella direzione parallela al *gate* 

